

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-031

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月4日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会，针对公司2025年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年10月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-030)，并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2025年11月4日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王虎先生、董事会秘书兼财务总监顾佳先生、独立董事董事黄海燕女士出席了本次说明会，针对公司2025年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

二、本次说明会召开情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1:您好，公司前三季度利润虽然同比保持良好增长，单季环比却出现停滞，但同类型封测公司却可以继续保持大幅度增长，离不开先进封测和AI芯片等需求的大幅度增长，想问一下:1.目前公司主要的cis封测业务发展是否遇到了瓶颈？2.贵公司投资visc公司已有多年，是否考虑在中国落地生产，打造海外研发+中国生产的模式？2.公司是否考虑像华天科技那样通过兼并，互补公司在AI芯片领域封测的短板？

回答:您好，不存在您说的发展瓶颈，随着AI及各项智能化应用的快速发展，CIS作为智能化终端视觉感知系统的核心构成，各项新的应用层出不穷，如智能驾驶、AI眼镜、机器人等，因此在智能化快速迭代发展的大趋势下，CIS市场将随之迎来快速发展机遇。公司作为全球传感器领域先进封装技术的领先者，在技术创新、生产能力、市场与客户等方面具备显著优势，也将受益于此发展趋势；关于公司投资的visc公司业务情况，请详见前述回答；公司专注于集成电光先进封装技术服务，为晶圆TSV先进封装技术的领导者。随着AI算力、存储等产业的快速发展，对TSV为代表的先进封装技术的需求与创新能力显著提升，公司将通过发挥核心技术竞争能力，聚焦市场与产业需求，积极推进技术创新与市场客户拓展，把握不断发展的产业与市场机遇。

问题2:公司第三季度营收和利润增长强劲(营收同比增长35.37%，净利润同比增长46.37%)。请问增长的主要驱动因素是什么？公司对全年业绩有何展望？

回答:随着汽车智能化的快速发展，单车摄像头搭载数量和价值量不断提升，驱动车规CIS芯片市场需求呈现显著增长趋势。公司作为全球车规摄像头芯片晶圆级TSV封装技术的领先者，在车规CIS领域的封装业务规模与技术领先优势持续提升。同时，公司也在不断拓展新的应用市场，一方面在CIS领域随着AI眼镜、机器人等终端市场的深入，公司在相关领域的业务规模呈现增长趋势；另一方面在非CIS领域，公司有效拓展MEMS、FILTER应用市场，量产规模也在逐步提升。感谢您的关注！

问题3:马来西亚槟城生产基地目前的具体建设进度如何？是否影响工期的因素？该基地明年的产品量产后客户订单是否顺利？

回答:目前马来西亚槟城生产基地已完成土地厂房的购买事宜，正在推进无尘室的设计与建设工作，各项工作均按照预计进度有效推进。

问题4:鉴于先进封装的运用领域逐渐拓展，公司除了传感器领域的布局，是否还有其他可能领域，如逻辑芯片、存储芯片领域拓展业务，扩大公司的收入范围。目前公司对于功率芯片的业务拓展进展如何，预计何时能够给公司带来显著的业绩增长？

回答:随着AI技术的快速发展，AI芯片、自动驾驶、AI手机等应用场景呈现快速增长趋势，对先进封装技术的创新与服务能力不断提升新的需求。AI芯片包含大量的计算核心，需要封装技术在有限空间提供高密度互连方案，如通过TSV硅通孔技术实现的堆叠、光电共封、光互连等。公司作为晶圆级TSV封装技术的引领者，一直在密切关注产业动态与市场需求，积极推进技术创新能力的创新开发与项目拓展。

公司投资的以色列Visc公司为全球领先的第三代半导体GaN(氮化镓)器件设计公司，正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V/650V/800V等逆变器方案，其D3GAN技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点。目前Visc公司一方面聚焦车用逆变器领域，积极和知名汽车厂家或Tier1商进行芯片及模块设计的合作，全力推进相关产品的规模化应用；另一方面围绕人工智能与数据中心快速发展的市场需求，积极进行产品开发布局，以期能为人工智能密集型数据中心提供高功率、低损耗、高可靠的功率模块产品方案；关于功率芯片业务的发展情况，请见前述回答。

问题5:您好？请问公司牵头的国家重点研发计划“MEMS传感器芯片先进封装测试平台”项目，在晶圆级键合、垂直互连等核心技术上是否取得实质性突破？项目针对的图像传感器、陀螺仪、压力传感器等产品的封装工艺是否已形成成熟技术方案？相关技术是否开始推进商业化量产或行业服务落地？盼复，谢谢！

回答:您好，该项目为公司牵头承担的国家重点研发计划项目，项目针对高

证券代码:002547 证券简称:春兴精工 公告编号:2025-098

## 苏州春兴精工股份有限公司 关于诉讼进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.案件所处的诉讼阶段：原告已撤诉。

2.上市公司所处的当事人地位：被告。

3.涉案的金额:约5,607.13万元。

4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼原告已撤诉，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不会对本期利润及期后利润产生重大影响。

一、诉讼基本情况

苏州春兴精工股份有限公司(以下简称“公司”、“春兴精工”)于2025年7月23日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于诉讼事项的公告》(公告编号:2025-065)，公司收到广东省中山市第二人民法院出具的《应诉通知书》[(2025)粤2027民初20097号]，福能东方装备科技股份有限公司(以下简称“福能东方”)就仙游润投资有限公司股权转让款事项向法院对公司提起诉讼。

二、诉讼进展情况

近日，公司收到广东省中山市第二人民法院出具的《民事裁定书》[(2025)粤2027民初20097号]，原告福能东方提出撤诉申请。

广东省中山市第二人民法院认为，原告福能东方申请撤诉，是其真实意思

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-135  
债券代码:128138 债券简称:侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 关于入选印度尼西亚废物转化能源项目选定供应商名单的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次为侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)入选印度尼西亚环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单，后续公司还需参加具体项目的合作伙伴选择程序，最终合作投资资格取得及后续合同签署执行存在不确定性。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

二、入选供应商名单的基本情况

公司近日收到印度尼西亚主权投资基金PT Dananarta Investment Management的来函，确定公司正式入选印度尼西亚环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单。

三、对公司的影响

公司成立于2001年，业务涵盖城乡环境一体化服务、环卫工程建设、垃圾分类等业务，具备垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营方面的综合实力。本次

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2025-123

## 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日:2025/2/25

回购方案实施期限:待股东大会审议通过后12个月

预计回购金额:7,500万元-15,000万元

回购用途:回购用于员工持股计划或股权激励、公司层面或部门层面的绩效考核等

累计已回购股数:63,100股

累计已回购金额:0.003%

累计已回购股数占总股本比例:0.003%

累计已回购金额:500,760元

实际回购价格区间:7.91元/股-7.95元/股

一、回购股份的基本情况

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股)股票，回购价格上限为人民币10.12元/股，回购资金总额不低于人民币7,500万元(含)且不超过人民币15,000万元(含)。回购期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。因公司2024年度、2025年中期权益分派实施完成，回购股份价格上限由

不超过人民币10.12元/股(含)调整为不超过人民币10.01元/股(含)。

具体内容详见公司于2025年3月15日、5月14日及9月18日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》、《2024年度权益分派实施公告》、《2025年半年度权益分派实施公告》(公告编号:2025-037,064,111)。

二、实施回购股份的进展情况

2025年10月，公司未以集中竞价交易方式回购股份。

截至2025年10月31日收盘，公司以集中竞价交易方式累计回购股份63,100股，占公司总股本比例为0.003%，回购的最高成交价格为人民币7.95元/股，最低成交价格为人民币7.91元/股，已支付的资金总金额为人民币500,760元(不含交易费用)。

本次回购执行符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项说明

公司将严格按照《上市公司回购股份规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及公司回购股份方案的规定，在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2025年11月5日

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:临2025-031

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
苏州晶方半导体科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月4日上午11:00-12:00通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会，针对公司2025年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

2025年10月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:临2025-030)，并向广大投资者征集大家所关心的问题。

公司于2025年11月4日上午11:00-12:00，通过价值在线路演中心(网址:https://www.ir-online.cn/)以网络文字互动的方式召开了2025年第三季度业绩说明会。公司董事长兼总经理王虎先生、董事会秘书兼财务总监顾佳先生、独立董事董事黄海燕女士出席了本次说明会，针对公司2025年第三季度经营成果、财务指标、发展战略等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在遵循信息披露规则的前提下，就投资者普遍关注的问题进行了回答交流。现将有关事项公告如下：

二、本次说明会召开情况

公司就投资者提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题1:您好，公司前三季度利润虽然同比保持良好增长，单季环比却出现停滞，但同类型封测公司却可以继续保持大幅度增长，离不开先进封测和AI芯片等需求的大幅度增长，想问一下:1.目前公司主要的cis封测业务发展是否遇到了瓶颈？2.贵公司投资visc公司已有多年，是否考虑在中国落地生产，打造海外研发+中国生产的模式？2.公司是否考虑像华天科技那样通过兼并，互补公司在AI芯片领域封测的短板？

回答:您好，不存在您说的发展瓶颈，随着AI及各项智能化应用的快速发展，CIS作为智能化终端视觉感知系统的核心构成，各项新的应用层出不穷，如智能驾驶、AI眼镜、机器人等，因此在智能化快速迭代发展的大趋势下，CIS市场将随之迎来快速发展机遇。公司作为全球传感器领域先进封装技术的领先者，在技术创新、生产能力、市场与客户等方面具备显著优势，也将受益于此发展

问题2:您好，公司前三季度利润虽然同比保持良好增长，单季环比却出现停滞，但同类型封测公司却可以继续保持大幅度增长，离不开先进封测和AI芯片等需求的大幅度增长，想问一下:1.目前公司主要的cis封测业务发展是否遇到了瓶颈？2.贵公司投资visc公司已有多年，是否考虑在中国落地生产，打造海外研发+中国生产的模式？2.公司是否考虑像华天科技那样通过兼并，互补公司在AI芯片领域封测的短板？

回答:您好，不存在您说的发展瓶颈，随着AI及各项智能化应用的快速发展，CIS作为智能化终端视觉感知系统的核心构成，各项新的应用层出不穷，如智能驾驶、AI眼镜、机器人等，因此在智能化快速迭代发展的大趋势下，CIS市场将随之迎来快速发展机遇。公司作为全球传感器领域先进封装技术的领先者，在技术创新、生产能力、市场与客户等方面具备显著优势，也将受益于此发展

问题3:马来西亚槟城生产基地目前的具体建设进度如何？是否影响工期的因素？该基地明年的产品量产后客户订单是否顺利？

回答:目前马来西亚槟城生产基地已完成土地厂房的购买事宜，正在推进无尘室的设计与建设工作，各项工作均按照预计进度有效推进。

问题4:鉴于先进封装的运用领域逐渐拓展，公司除了传感器领域的布局，是否还有其他可能领域，如逻辑芯片、存储芯片领域拓展业务，扩大公司的收入范围。目前公司对于功率芯片的业务拓展进展如何，预计何时能够给公司带来显著的业绩增长？

回答:随着AI技术的快速发展，AI芯片、自动驾驶、AI手机等应用场景呈现快速增长趋势，对先进封装技术的创新与服务能力不断提升新的需求。AI芯片包含大量的计算核心，需要封装技术在有限空间提供高密度互连方案，如通过TSV硅通孔技术实现的堆叠、光电共封、光互连等。公司作为晶圆级TSV封装技术的引领者，一直在密切关注产业动态与市场需求，积极推进技术创新能力的创新开发与项目拓展。

公司投资的以色列Visc公司为全球领先的第三代半导体GaN(氮化镓)器件设计公司，正在积极开发基于硅基氮化镓技术的400V/650V/800V等逆变器方案，其D3GAN技术具有导通电阻低，开关频率高，损耗小，可靠性高等特点。目前Visc公司一方面聚焦车用逆变器领域，积极和知名汽车厂家或Tier1商进行芯片及模块设计的合作，全力推进相关产品的规模化应用；另一方面围绕人工智能与数据中心快速发展的市场需求，积极进行产品开发布局，以期能为人工智能密集型数据中心提供高功率、低损耗、高可靠的功率模块产品方案；关于功率芯片业务的发展情况，请见前述回答。

问题5:您好？请问公司牵头的国家重点研发计划“MEMS传感器芯片先进封装测试平台”项目，在晶圆级键合、垂直互连等核心技术上是否取得实质性突破？项目针对的图像传感器、陀螺仪、压力传感器等产品的封装工艺是否已形成成熟技术方案？相关技术是否开始推进商业化量产或行业服务落地？盼复，谢谢！

回答:您好，该项目为公司牵头承担的国家重点研发计划项目，项目针对高

证券代码:603876 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2025-092

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

### ● 担保对象及基本情况

被担保人名称	内蒙古联泓新材料有限公司(以下简称“联泓新材”)
本次担保金额	10,000.00万元
实际为担保的担保余额	132,125.85万元
是否在定期报告中披露	是
是否在定期报告中披露	是
被担保人名称	杭州五星铝业有限公司(以下简称“五星铝业”)
本次担保金额	30,000.00万元
实际为担保的担保余额	104,142.40万元
是否	